

电子

影目科技发布 AR+AI 眼镜，AI 眼镜终端如火如荼

投资要点：

➤ 影目两款 AI 眼镜齐上阵。

2024 年 11 月 29 日，AR 创新企业影目科技发布其创新成果的最新里程碑——两款接入 AI 大语音模型的智能眼镜：INMO AIR3 和 INMO GO2。INMO AIR3 采用了类普通眼镜的外观设计，镜框中央有一颗 1600 万像素 RGB 摄像头，用以摄影摄像、AI 识别等。相比 INMO AIR2，INMO AIR3 分辨率提升了 8.1 倍、视场角提升 2 倍，亮度提升 3 倍、刷新率提升 2 倍。INMO GO2 相比于上一代升级为双目双光机设计，FOV 达到 30 度，在高透过的衍射波导加持下，带来了更好的视觉体验。INMO GO2 还将在后续引入 AI 定向拾音算法，通提高在多人环境下的翻译精准度。根据 wellsenn XR 数据，2023 年~2024 年 Q3，AI 智能眼镜领域，影目科技产品在国内市场份额位居首位，占比约 41%，具有重要产业地位，其重磅产品发布将 AI 眼镜终端的趋势继续深化，加速发展。

➤ AI 智能眼镜为 AI 落地的最佳载体之一，2025 年将加速渗透。

传统终端无法满足的视觉需求不断推动着视觉技术的创新，而眼镜通过虚拟世界与真实世界的交互来为用户创造沉浸式的视觉环境，同时是靠近人体三大重要感官的穿戴设备，可以实现自然的声音、语言的输入输出。因此，基于能解放双手的穿戴式体验、与视觉高度融合的特点，智能眼镜正在成为重要的 AI 硬件落地形式。AR 眼镜或为 AI 的最佳载体之一，但其成熟之路是循序渐进的过程，而不带显示屏的 AI 眼镜作为 AI AR 眼镜的过渡形态，因具备 AI 交互功能，同时兼顾价格和基本性能，故而有望在 C 端快速渗透。而随着 AR 各硬件模块的完善和多模态 AI 的快速发展，AI 赋能下的 AR 眼镜有望成为 AI 智能眼镜的最终形态，引领可穿戴设备的新趋势。根据 wellsenn XR 预测，2025 年开始，AI 智能眼镜将快速向传统眼镜渗透；2029 年，AI 智能眼镜年销量有望达到 5500 万副；到 2035 年，AI 智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代，达到 70% 的渗透率。

➤ 投资建议

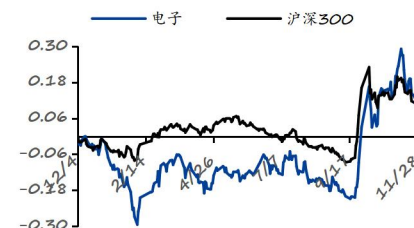
AI 眼镜终端方向，建议关注歌尔股份、亿道信息、立讯精密、华勤技术、水晶光电、韦尔股份、舜宇光学科技、兆易创新、佰维存储、恒玄科技、瑞芯微、炬芯科技、杰美特、长盈精密、京东方 A 等。

➤ 风险提示

技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

强于大市（维持评级）

一年内行业相对大盘走势



团队成员

分析师：杨钟(S0210522110003)

YZ3979@hfzq.com.cn

联系人：唐小璿(S0210123120002)

zxm30169@hfzq.com.cn

相关报告

- 1、美对华科技封锁或将加码，自主可控加速攻坚——2024.11.25
- 2、24Q3AIPC 市场保持强劲发展步伐，AI 终端持续出新——2024.11.18
- 3、先进制程供应链再迎挑战，国产化迫在眉睫——2024.11.11



正文目录

1 本周市场表现.....	3
1.1 电子板块本周表现.....	3
1.2 SW 电子个股本周表现.....	3
1.3 电子板块估值分析.....	4
2 行业动态跟踪.....	6
2.1 半导体板块.....	6
2.2 AI.....	14
2.3 消费电子板块.....	15
2.4 汽车电子板块.....	18
2.5 面板板块.....	19
3 公司动态跟踪.....	20
4 风险提示.....	22

图表目录

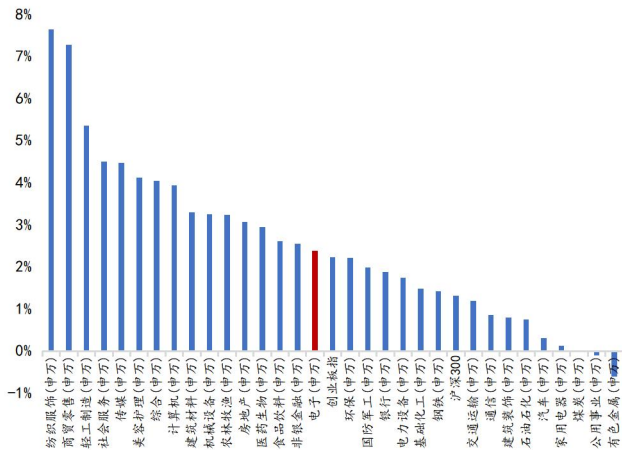
图表 1: SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2: 电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3: 电子细分领域本周涨跌幅 (%).....	3
图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%).....	4
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%).....	4
图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%).....	4
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM).....	5
图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM).....	5
图表 9: 过去一周股东增减持更新.....	20
图表 10: 过去一周股权激励一览.....	21

1 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

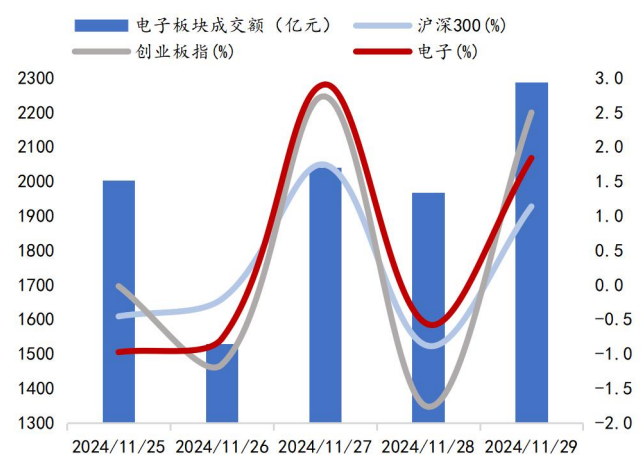
大盘表现上，本周（1125-1129）创业板指数上涨 2.23%，沪深 300 指数上涨 1.32%。本周电子行业指数上涨 2.38%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 16 位，本周纺织服饰、商贸零售、轻工制造板块涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



来源：Wind，华福证券研究所

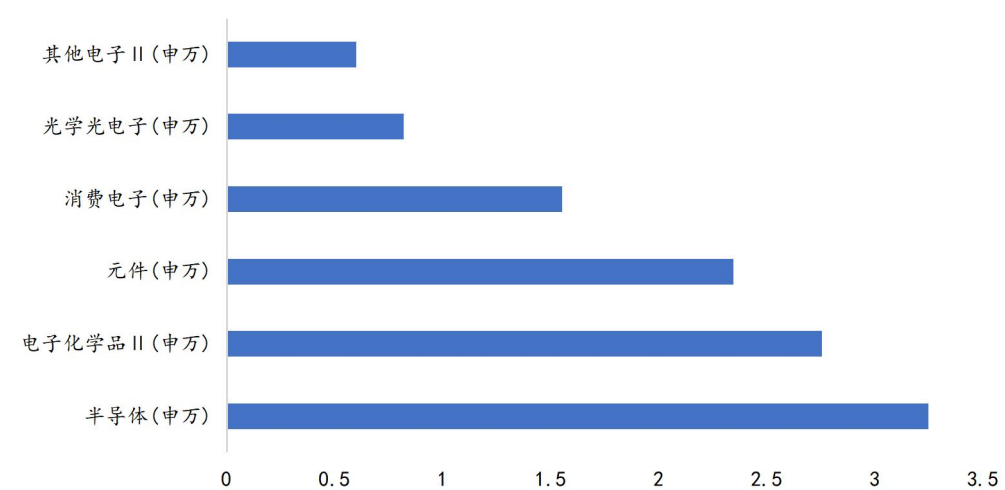
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块均呈上涨态势，具体来看，半导体板块涨幅最大，周涨跌幅为 3.25%；其他电子板块涨幅最小，周涨跌幅为 0.60%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅 (%)

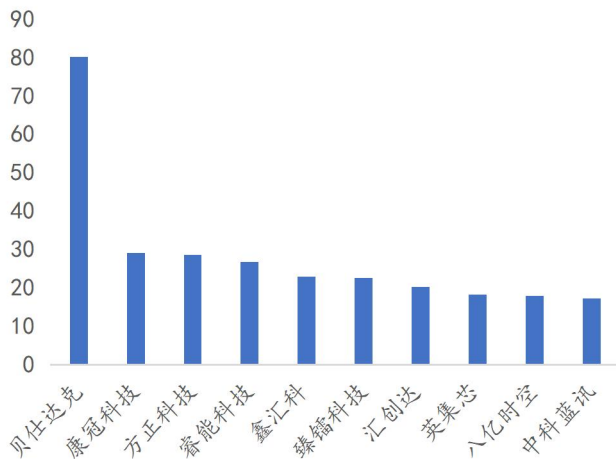


来源：Wind，华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

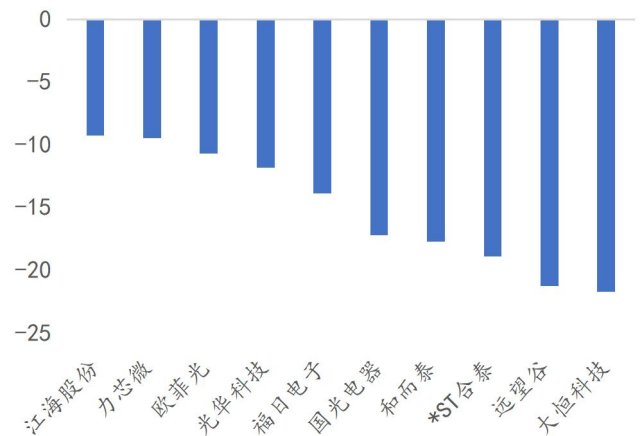
从个股维度来看，SW 电子板块中，贝仕达克（80.19%）、康冠科技（29.08%）等位列涨幅前列；大恒科技（-21.71%）、远望谷（-21.26%）等位列跌幅前列。

图表 4：SW 电子本周涨幅前十个股（%）



来源：Wind，华福证券研究所

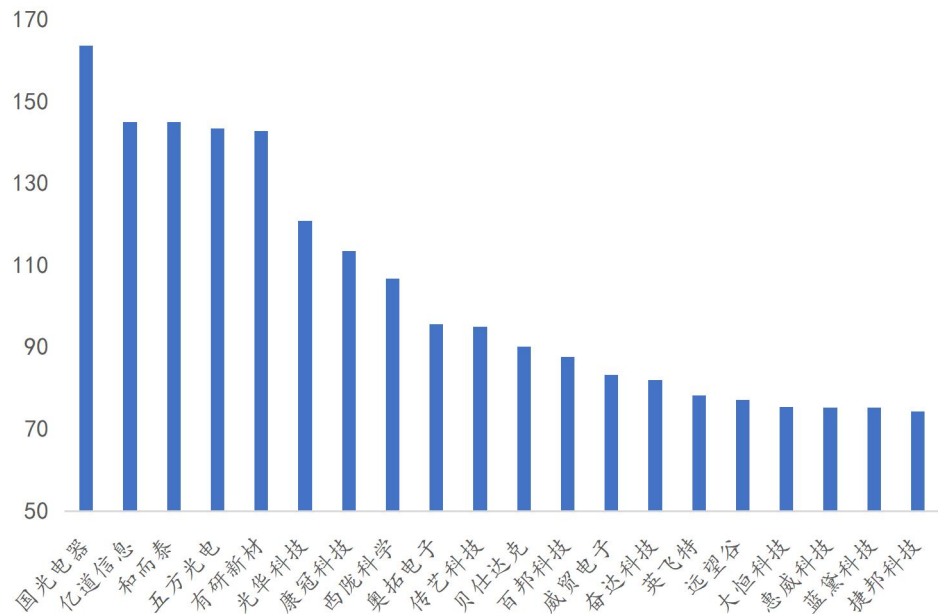
图表 5：SW 电子本周跌幅前十个股（%）



来源：Wind，华福证券研究所

从换手率来看，本周电子行业个股换手率最高的是国光电器，换手率为 163.71%。其余换手率较高的还有亿道信息（144.00%）、和而泰（144.95%）、五方光电（143.51%）。

图表 6：SW 电子本周换手率前二十个股（%）



来源：Wind，华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看，整体电子行业估值高于近一年、三年、五年平均值水平。本周 PE（TTM）为 54.06 倍，较上周有所上调。



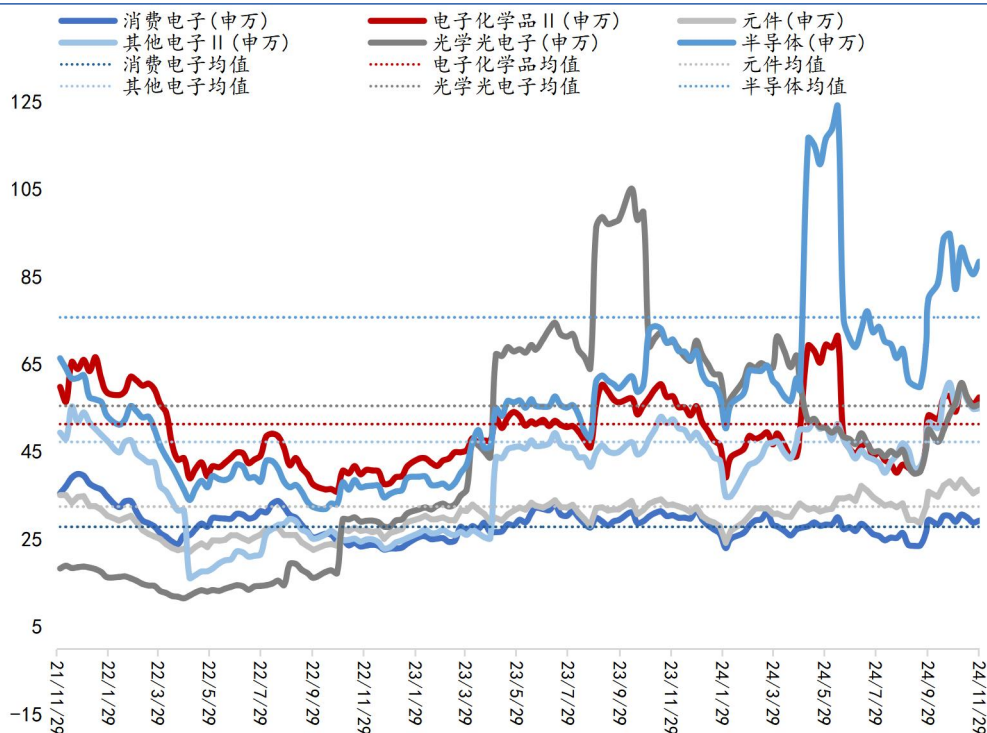
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 29.26、57.43、36.33、54.92、55.83 和 88.46, 本周电子细分板块估值均有一定程度上调。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



来源: Wind, 华福证券研究所



2 行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) 拜登政府“小院高墙”最后一搏，中国应探索“内外统筹”反制路径

在政权过渡时期，拜登政府还在酝酿似乎冲击力更剧烈的“大招”。

业界盛传美国政府近日将对华实施新出口禁令，新规定可能会将多达 200 家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向目标公司发货，其中可能包括限制向中国出口芯片制造工具。另外，作为更广泛的人工智能计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽内存芯片（HBM）的规则预计将于下个月公布。

然而，拜登政府出口管制新规一再延迟“跳票”，也说明其面临的压力和挑战不言而喻，包括政界、商界等各方力量仍在针对所谓管制措施进行迂回争论和修订，同时该举措被视作确保其政治遗产得以延续，而影响无异于“杀敌八百，自损一千”。但面对美国的系列制裁措施，国内仍需做好应对，初步探索“内外统筹，多元并举”的反经济制裁路径。

关于美国拟更新出口管制新规，包括扩展贸易限制名单以及限制芯片制造工具和存储芯片出口其实早已有传闻。

据此前报道称，美国政府拟在 8 月出台一系列新制裁措施，包括阻止美光、SK 海力士、三星向中国企业供应用于人工智能的 HBM 芯片；将大约 120 家中国实体添加到制裁名单中，涵盖 6 家芯片制造工厂以及一些设备制造商、EDA 等相关公司等；限制中国台湾、马来西亚、以色列、新加坡等地的半导体企业与中国半导体企业的合作。

可以看出其与上述曝出的信息有较高重合度，同时若将制裁名单由 120 家增加至 200 家也显示出其管控力度加大，但美国出口管制新规也鉴于复杂形势出现一再延迟“跳票”。

总体上，随着美国对华战略打压的态势愈加严峻，美国对华制裁或将会进入更加“紧密”的阶段。行业分析认为，在对华出口管制上，川普 2.0 将从拜登政府的“小院高墙”升级“高院高墙”，将更全面性、更具针对性的针对中国半导体、AI 等产业进行打压。但也有观点指出，川普 2.0 将进一步推行美国单边主义，在全球协同盟友进行管制方面将遭遇挑战。（资料来源：集微网）

2) 三季度全球 NAND 闪存产业营收增长 4.8%

近日，根据 TrendForce 集邦咨询的数据显示，2024 年第三季度全球 NAND 闪存产业整体营收达 176 亿美元，季增 4.8%，但出货量环比下降 2%，ASP（平均销售价格）上涨 7%。



TrendForce 表示，第三季度 NAND 闪存定价趋势在各个应用领域呈现分化。

企业级 SSD 需求强劲，推动平均售价上涨近 15%，而客户级 SSD 价格在订单减少的情况下仅出现小幅增长。

TrendForce 称，由于中国智能手机品牌坚持低库存策略，智能手机 NAND 闪存产品订单减少，合约价格与上一季度基本持平。与此同时，由于零售市场需求疲软，晶圆合约价格出现逆转并开始下跌。（资料来源：集微网）

3) 台积电引领高端制程，估非 AI 半导体需求 2025 年回升

研究机构 Counterpoint Research 11 月 29 日发布 2024 年第三季全球晶圆代工产业相关新闻稿，其中提到台积电引领高端制程市场并估非 AI 半导体需求 2025 年稳步回升。

该机构分析，全球晶圆代工产业 2024 年第三季度营收季增 11%，年增 27%，受 AI 与高端制程智能手机需求带动，包括台积电 N5 和 N3 在内的高端制程成为晶圆代工产业的主要增长动力，受 AI 和智能手机半导体需求强劲支撑。非 AI 半导体需求依然疲软，但成熟 12 英寸制程的需求复甦表现优于 8 英寸制程。

该机构分析，至于中国大陆晶圆代工厂商如中芯国际和华虹半导体在成熟制程领域表现超越全球同行，总体产能利用率回升至 90% 以上，得益于中国大陆需求复苏及本地化进程推动。随着更多新增产能投入运行，预计进入 2025 年后，成熟制程晶圆代工市场的竞争将进一步加剧。

该机构分析，台积电 2024 年第三季度表现强劲，凭借 AI 加速器需求及智能手机旺季带动，其 N5 与 N3 制程利用率居高不下，毛利率表现优于市场预期。台积电的全球晶圆代工市占率从第二季的 62% 上升至 64%。台积电预期未来 AI 需求将大幅增长，2024 年 AI 服务器收入占其总营收的比重已达中双位数，并有望进一步提升。即便宣布将于 2025 年再次至少倍增其 CoWoS 产能，仍不足以满足客户对 AI 需求的强劲需求。此外，台积电预计非 AI 半导体需求将于 2025 年起稳步回升，缓解市场对半导体週期触顶的担忧。（资料来源：集微网）

4) 芯片战争作者：川普 2.0 聚焦减税，补助半导体厂机率低

美国依芯片法提拨 390 亿美元补助金，如今川普再次上台，外界忧补助生变。《芯片战争》作者米勒表示，两党都挺芯片法，未来框架不至于大规模变动，但新一届国会聚焦减税，未来批准更多补助的可能性低。

2022 年美国国会在两党支持下通过芯片法，允诺提供补助给 21 家企业，借此吸引芯片制造商将产线从亚洲拓展到美国。补助金多流向台积电、英特尔、三星电子等。

他推测，美国政府与不同半导体公司签署的许多协议将在今年底之前完成，也



就是在拜登政府任期结束前，代表这些协议将大致抵定，芯片法的补助金流向也相当明确。

芯片法提拨的 390 亿美元补助金用罄后，是否会出现芯片法 2.0 持续予以补助，以维系美国芯片制造动能，米勒并不乐观。他指出，政府已经决定如何支配已拨出的 390 亿美元，未来如果想要更多的资金就需国会批准，但新一届国会将聚焦减税，不利半导体业者获得更多补助。

对于川普上任前就喊加关税的影响，米勒说，从川普第一任期可见他毫无顾忌地祭出关税威胁，但最后只有一部分得以实施，期间也进行许多谈判。川普再次上台后，一来一往的谈判应该也不少，实际落实的关税可能远远低于宣称的数字，范围也没有那么广。

米勒也认为，美国在半导体制造领域将持续与中国台湾、日本及韩国合作，因为国际半导体供应链之所以能运作，完全依赖欧美、中国台湾、日本和韩国合作，没有任何一国能够自给自足，也不可能实现自给自足，就看具体条件怎么谈。

米勒认为，美中 AI 芯片运算能力未来几年可能保持一样的差距，因为台积电在技术上仍将明显领先中国大陆的中芯国际。虽然有人可能认为未来更先进的芯片制造技术未必那么重要，但至少在未来几年内，能否取得台积电的技术仍是重中之重。（资料来源：集微网）

5) 全球 DRAM 市场 Q3 营收大增 13.6%至 260 亿美元

据分析机构 TrendForce 的研究显示，2024 年第三季度全球 DRAM 市场规模达到 260.2 亿美元，环比增长 13.6%。

这一增长主要得益于数据中心对全球 DRAM 和 HBM 产品需求的增加，尽管由于中国智能手机品牌减少库存以及中国 DRAM 供应商扩大产能，LPDDR4 和 DDR4 的出货量有所下降。

ASP（平均销售价格）延续了上一季度的上升趋势，合约价格上升了 8%至 13%，这得益于 HBM 取代传统 DRAM 生产。

展望 2024 年第四季度，TrendForce 预计整体 DRAM 出货量将环比增加。该机构表示，由于 HBM 生产导致的产能限制预计对价格的影响将“弱于预期”。中国供应商的产能扩张可能会促使 PC OEM 和智能手机品牌“积极去库存”以获取价格更低的 DRAM 产品。因此，传统 DRAM 的合约价格以及传统 DRAM 和 HBM 的混合价格“预计将下降”。

服务器和 PC DRAM 合约价格的上涨在第三季度提升了三大 DRAM 制造商的收入。三星以 107 亿美元的营收保持了第一的位置，环比增长 9%。通过战略性地清理 LPDDR4 和 DDR4 库存，三星的出货量与上一季度持平。



SK 海力士的营收为 89.5 亿美元，环比增长 13.1%，保持了第二的位置。尽管其 HBM3e 出货量增加，但由于 LPDDR4 和 DDR4 销售疲软，出货量环比下降了 1% 至 3%，抵消了这些收益。

美光的营收环比激增 28.3%，达到 57.8 亿美元，得益于服务器 DRAM 和 HBM3e 出货量的“强劲增长”，导致出货量环比增加了 13%。（资料来源：集微网）

6) 透视意法与华虹合作，国产芯片成熟制程发力

近日，有消息称，意法半导体宣布将与华虹半导体合作，到 2025 年底在无锡生产 40nm 工艺节点的微控制器（MCU）。在中美贸易冲突持续加剧，一些国际企业筹谋将供应链转移出中国大陆的背景下，意法半导体的这一举措颇为醒目。业界对于此举的解读多为，意法半导体受到中国新能源汽车市场高速发展的吸引，希望加大大地化投入，增强对用户的响应速度。这当然无可争议，但是同时还应注意到，中国企业的芯片制造能力，特别是在成熟制程方面，经过一段时间的努力已经取得较大进步，并且获得国际大厂的认可。这也是本次合作得以达成的必要因素。

意法加强中国本土供应链

近年来，中国新能源汽车产业快速成长，不仅在国内市场占据显著份额，还在国际舞台上展现强劲竞争力。这一蓬勃发展的态势吸引了越来越多国际芯片大厂的注意，并且积极寻求合作。意法半导体在电动汽车的碳化硅与微控制器领域都是国际领先的供应商，用户包括特斯拉和吉利等，近年来也在不断加大对中国市场的投入。

受到工业和汽车领域营收下滑等因素的影响，意法半导体第三季度营收同比下降 27% 至 32.5 亿美元，净利润同比下降 67.8% 至 3.51 亿美元。在此情况下，意法半导体更加希望能够通过扩展 12 英寸硅晶圆和 8 英寸碳化硅工艺的产能，以对冲相关的市场风险。而中国既是最主要的新能源汽车市场，近年来在芯片成熟制程方面又取得显著进展。这或许正是意法半导体与华虹半导体达成合作的主要原因。

华虹成熟制程受青睐

华虹半导体是国内第二大晶圆代工厂，一直以来都致力于成熟特色工艺的开发。据报道，华虹半导体可以提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。同时，华虹半导体还积极拓展知识产权（IP）设计、测试等配套服务，进一步丰富产品线，提升综合竞争力。

目前，在全球范围内，面向成熟制程的 12 英寸晶圆生产线建设成为大趋势。华虹半导体在不断提升技术实力的同时，也在不断扩充 12 英寸产能，力争在 12 英寸成熟特色工艺领域保持领先地位。资料显示，华虹半导体除在上海金桥和张江建有



三座月产能约 18 万片的 8 英寸晶圆厂之外，在无锡还建有一座月产能 9.45 万片的 12 英寸晶圆厂。这不仅是全球领先的 12 英寸的集成电路特色工艺生产线，也是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。目前，华虹半导体正在推进华虹无锡二期 12 英寸生产线的建设，预计明年第一季度到上半年，新产线将开始贡献销售收入。

成熟制程产能占比将达 39%

华虹半导体在成熟制程方面的快速发展只是近年来国产芯片制造领域的一个缩影。由于受到美国政府对华芯片产业的无故打压，先进制程技术和设备进口受到管制，国内企业转而扩大投入成熟制程的开发。长期以来，中国一向是全球最大的芯片市场，面临本土产能严重不足的境况。在先进制程发展受限之下，只能从成熟制程进行积累，再慢慢向先进制程演进，这为中国成熟制程的发展提供了充足的动力。

根据集微咨询的统计，目前中国大陆已有 47 座晶圆厂，其中，12 英寸晶圆厂 22 座，8 英寸厂 25 座。此外，还有正在建设的晶圆厂 25 座。无论已建还是在建，大多均锁定成熟制程。研究机构 TrendForce 也预计，到 2027 年中国大陆成熟制程产能的全球占比将达到 39%。

值得注意的是，成熟制程的发展还带动了国内半导体装备材料等上游产业链的成长。目前中国已是全球最大的半导体设备需求市场之一，随着晶圆产能的持续扩张，对国产半导体设备的采购也将进一步增长。研究机构 TechInsights 预测，到 2029 年中国大陆半导体产能将增长 40%，达到 875msi（百万平方英寸）。而中国大陆的晶圆制造设备支出从 2018 年的 110 亿美元增长到 2023 年的近 300 亿美元。设备采购的增长成为设备制造行业发展的驱动力。（资料来源：集微网）

7) 台积电或在 2025 年后将先进 2nm 制造转移美国

特朗普胜选后，市场关注台积电 2nm 是否可能提前赴美生产。中国台湾科学技术部门官员吴诚文表示，台积电 2nm 制程将于明年量产，这时候台积电应已开始新一代制程的研发，就可以跟台积电讨论，是否要在友好地区投资 2nm。

吴诚文指出，特朗普竞选期间言论提及“抢走”，应该是半开玩笑。吴诚文强调，中国台湾并没有抢走美国的半导体技术，中国台湾半导体制造技术的能力，是台积电从 2000 年左右决定投入先进制程的研发开始，一步步拥有相关专利，“这些专利是我们自己开发出来的”。

吴诚文进一步表示，半导体技术涉及层面很广，包含设计、材料、设备、元件、理论，所谓技术，不能单纯简化到只有制造，从整体来讲，目前全世界最领先的仍是美国，但中国台湾在半导体的制造量、良率、获利能力方面，台积电绝对居全世界独一无二地位，是做得最好的公司。

在演讲中，吴诚文还被问及是否担心中国台湾半导体产业“空心化”。他回答



说，这种情况不太可能发生，因为台积电所有的研发设施都位于中国台湾地区内。尽管《芯片法案》鼓励台积电在美国设立制造工厂，类似的举措也吸引了该公司前往日本等其他国家，但这些交易并未促成台积电在国外设立研发中心。

吴诚文说明，先进制程技术的研发一定会留在中国台湾，研发成功以后，中国台湾也会愿意将之扩散到友好地区、协助其建厂。（资料来源：集微网）

8) 台积电 2027 年推出 9 个掩模尺寸的超大版 CoWoS 封装，可放置 12 个 HBM4 堆栈

台积电 11 月欧洲开放创新平台（OIP）论坛上宣布，该公司有望在 2027 年认证其超大版本的 CoWoS（晶圆上芯片）封装技术，该技术将提供高达 9 个掩模尺寸的中介层尺寸和 12 个 HBM4 内存堆栈。新的封装方法将解决性能要求最高的应用，并让 AI（人工智能）和 HPC（高性能计算）芯片设计人员能够构建手掌大小的处理器。

台积电每年都会推出新的工艺技术，尽最大努力满足客户对 PPA（功率、性能和面积）改进的需求。但有些客户需要更高的性能，而 EUV 光刻工具掩模限制 858 平方毫米是不够的。这些客户选择使用台积电 CoWoS 技术封装的多芯片解决方案，近年来，该公司提供了该解决方案的多个迭代版本。

该 9 个掩模尺寸的“超级载体” CoWoS（为芯片和内存提供高达 7722 平方毫米的面积）具有 12 个 HBM4 堆栈，计划于 2027 年获得认证，推测它将在 2027 年至 2028 年被超高端 AI 处理器采用。（资料来源：集微网）

9) 传小米 2025 年正式发布自研 3nm SoC 芯片

安卓智能手机制造商通常依赖高通和联发科提供“现成”的芯片，据说 2024 年和 2025 年的大多数高端版本都包含骁龙 8 Elite 和天玑 9400。小米在很大程度上也将依赖上述两家公司。然而，该公司很可能开始意识到，在未来维持对这些合作伙伴的依赖只会让成本变得更加昂贵，而提高盈利能力的唯一方法是启动其定制芯片业务。根据最新报道，小米将于 2025 年正式推出自研 3nm SoC 芯片，预计会让竞争对手感到紧张。该处理器可能有助于小米提高自给自足能力，并在由高通客户主导的安卓市场中脱颖而出。

报道指出，小米将在 2025 年正式推出自研手机 SoC 芯片，几乎已经是板上钉钉，半导体相关供应链也表示确有此事，指出小米已经准备好将在 2025 年正式量产，只是现在还无法完全确定，究竟这颗处理器会导入到哪一款机型。（资料来源：集微网）

10) 台积电高雄首座 2nm 晶圆厂设备进场，明年上半年试产

11 月 26 日，台积电高雄首座 2nm 晶圆厂举行了设备进场仪式，预计将于明年上半年开始试产。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/885340213031012004>